

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-08

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他：券商策略会
参与单位名称	汇添富基金、富荣基金、附加值投资、禾永投资、兴合基金、国新证券、新石投资、红土创新基金、云溪基金、云禧基金、创金合信基金、华熙集团、财富在线、宝创资本、裘明投资、四创资本、东吴证券、东方财富证券、东北证券、国金证券
时间	2026 年 8 月 26 日—9 月 1 日
地点	北京、深圳，公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：高健 董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	1、广芯微电子产线良率水平如何，以及工艺平台进展情况？ 答：广芯微电子已量产产品包括 MOS 场效应二极管产品（MFER）、VDMOS、TVS 等，其中，面向工业、能源等领域的特高压电源产品平均良率超 95%，消费类电源及电机驱动产品平均良率达 98%以上，已量产产品的良率处于国内领先水平。除此之外,IGBT 和 700V 高压 BCD 产品处于客户流片与导入阶段，产品的核心工艺环节都已完成验证，现有设备已具备量产能力。 2、晶圆代工厂一期十万片产能还需增加多少投资，以及产能释放节奏？ 答：预计还需增加 7 亿元投资，公司 2026 年定增中 7 亿元拟用于 6 英寸功率半导体晶圆代工产线扩产，达产后，预计将新增适用于高压、大功率领域的特高压 VDMOS、IGBT 和 700V 高压 BCD 等产品的晶圆代工产能 6 万片/月。 广芯微电子已陆续签订了扩产至 6 万片月产能的设备合同,且部分设备已开始进场；同时，公司也在和多家供应商洽谈扩产至 10 万片的设备，争取以最快速度敲定完成。晶圆厂的产能预计今年四季度和明年上半年开始会有明显释放，具体视设备进场和调试

进度而定。

3、当前 6 英寸功率半导体晶圆代工市场情况如何？

答：从去年下半年开始，由于 AI 数据中心、电网升级等领域的带动，市场需求呈现高速增长态势，其中内存涨价 10 倍以上，电容、电阻、二极管、三极管等也都在涨价。受制于晶圆制造的复杂程度，以及出于供应链安全考虑而带来的本土化布局，晶圆代工新增产能会受到制约，需求远大于供给，未来 3~5 年将是晶圆代工行业的景气周期。

需求端，随着 AI 大模型算力呈指数级攀升，大型数据中心用电规模已迈入吉瓦级，供电能力成为制约 AI 规模化落地的核心瓶颈——“AI 的尽头是电力”已成行业共识。每一瓦电能都要经过功率半导体进行转换与分配，GPU 功耗逐代攀升，带动功率芯片用量成倍增长。而这些 MOSFET、IGBT、高压 BCD 等器件恰恰主要在 6、8 英寸成熟制程生产，功率器件对线宽要求不高、但对耐压可靠性要求极高，6 英寸高压工艺反而最匹配、性价比最高。

供给端，台积电、三星等国际巨头正集中资源投向先进制程，扩大 12 英寸产能，同时逐步收缩 6、8 英寸成熟制程产能。在国际巨头主动收缩成熟制程产能的同时，下游需求正迎来结构性复苏。AI 带动的电源管理芯片、功率器件等成熟制程需求呈指数级增长，供需关系趋于紧张。供需失衡的结果是，目前国内 6、8 英寸晶圆代工厂产能利用率接近满产，6 英寸产能正在成为稀缺资产。

综上，6 英寸功率晶圆代工因匹配功率器件工艺特性、叠加巨头让出成熟制程等因素，成为本轮 AI+电力革命中最紧缺的资产之一，预计未来 3-5 年将处于行业景气周期。

4、广芯微电子的二期项目如何规划？

答：广芯微电子一期项目规划为月产 10 万片 6 英寸硅基晶圆加工产能，厂区基础设施已全部完成建设，二期项目只需再建一栋生产厂房添加设备即可，预计比新建厂会快很多。公司将尽快推进一期项目满产，并择机启动二期项目建设。

5、功率半导体设计公司广微集成业务进展情况如何？

答：广微集成 MOS 场效应二极管产品（MFER）月销量从 2025 年初 1 千多片大幅增长至今年 8 月的超 2 万片，预计将保持稳定增长。

风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

附件清单（如有）	无
日期	2026-09-01